



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H1500-R取向化系列

【导热硅胶垫片】规格书



- 产品图 -

应用特点：

- 表面柔软，可压缩性好
- 低热阻
- 轻质化
- 低压力下应用
- 良好的热稳定性

应用领域推荐：

- 军工
- 雷达
- 大型服务器
- GPU、图像处理器
- 高频网通设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度： $\leq 30^{\circ}\text{C}$

储存湿度： $\leq 70\%$

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H1500-R 是一款具有超高导热系数、超低热阻抗的新型取向化导热垫片。通过使用一种先进的排列技术，将高导热填料均匀、垂直分布在高分子基体中，可大幅提高热量传递的效率。同时，低的填充比使得材料具有很好的力学性能和优异的热稳定性。广泛应用于对散热要求比较高的电子领域。

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	黑色	---	目视
标准尺寸	150*150	mm	ASTM D 5947
厚度	0.5~2	mm	ASTM D374
硬度	45±5	Shore 00	ASTM D 2240
密度	1.5±0.2	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	0.25	Mpa	ASTM D 412
延伸率	100	%	ASTM D 412
压缩比	≥ 40 (@50Psi)	%	ASTM D 695
阻燃等级	V-0	---	UL-94
使用温度	-50~180	$^{\circ}\text{C}$	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	15.0	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤ 0.2 (@20Psi/1mm)	$^{\circ}\text{Cin}^2/\text{W}$	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥ 1.5	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	$\geq 10^8$	$\Omega\cdot\text{cm}$	ASTM D 257

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

